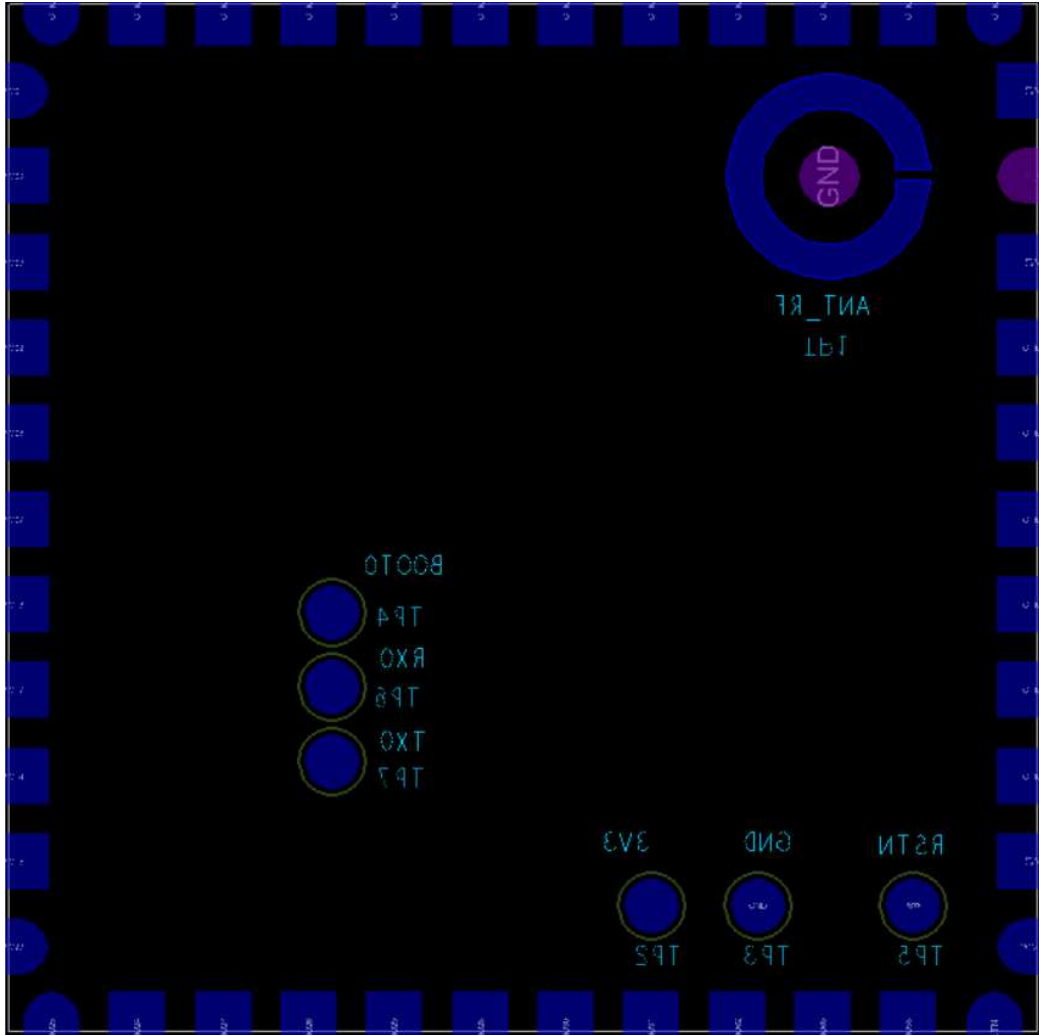


ASR6601QFN68 Module V10 拼板制板要求

一. PCB 制作要求:

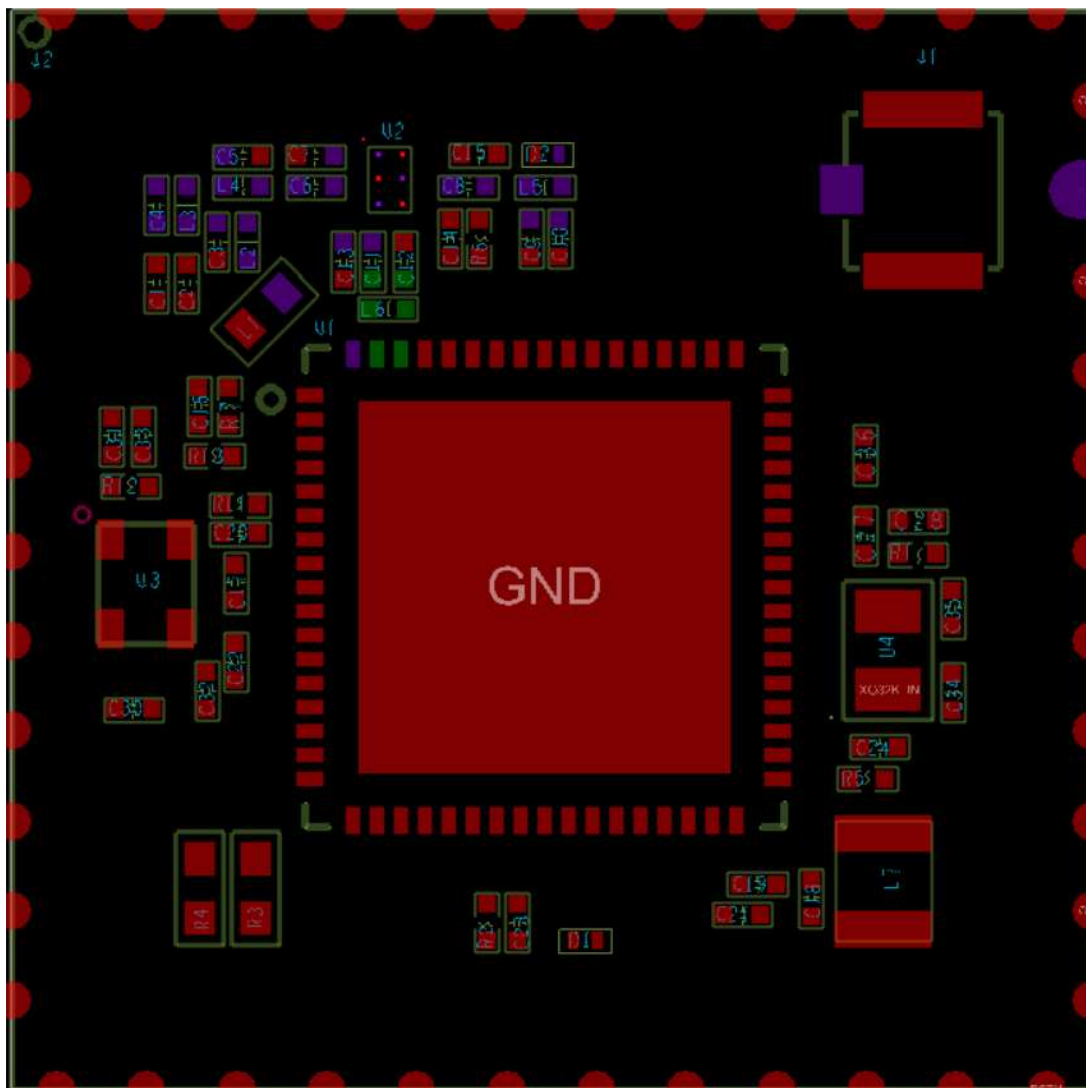
1. 4 层板，板厚 1.0mm，板材用 FR4，表面采用黑色油墨阻焊。
 2. 四层板的叠层顺序为：TOP->GND->VCC->BOTTOM。
 3. 镀层要求:化学镍金，表面光泽，厚度：Ni:3~5um, Au: >0.05um 。
 4. 空板来料必须经过断短路测试，丝印不能上 PAD，必须清晰可见。
 5. Top 层最外面 0.6mm 宽的区域为屏蔽罩，屏蔽罩的 shape 开窗。
 6. 屏蔽罩 Shape 上面有两个 1.0*0.35mm 的定位孔，用于固定屏蔽罩。
 7. 板子边缘采用邮票孔，bottom 层的焊盘为方形焊盘，需要开窗。
- Bottom 层的测试点 TP1 测试点是 RF 测试点，外面包地圆环的铜皮必须漏出来。



ASR6601QFN68_Moduleboard_V10

8. RF 阻抗匹配，

- a) 紫色是 RF 走线，需要做 50 欧姆单端阻抗匹配。
- b) 绿色的也是 RF 走线，需要做 100 欧姆的差分阻抗匹配。



ASR6601QFN68_Moduleboard_V10

二. 拼板设计要求:

1. 拼板按照客户的要求处理。
2. 工艺边 5mm, Mark 采用直径 1.0mm 光亮裸露, 外圆直径 3.0mm 为宜, 中间不能有走线。
3. Mark 点相对位置设计: 每片 PCB 的两个 Mark 点相对坐标位置及尺寸必须完全相同。否则 SMT 不能贴装。
4. 板上不要有贵公司的标识。

三. 制造:

1. PCB 厂商在制造 PCB 时, 尽量将 PCB 拼板周边的铜腐蚀掉以 PCB 整板平整。否则, 在 SMT 时影响贴片。
2. 删除 0.35mm 钻孔的开窗, 该孔为通孔 (屏蔽罩的定位孔); 其他 8mil, 10mil 为过孔, 所有过孔按塞孔处理。
3. 在器件焊盘 (PAD) 旁边不能有过孔焊盘相连, 至少应有油墨隔开, 以免锡流入过孔而导致焊盘本身少锡。



过孔与器件过孔相连, 容易导致锡流入过孔。



过孔与器件分离, 正确